

# パワーモジュールの パッケージング技術の動向

## ■講演会趣旨

パワーモジュールのパッケージング技術の動向について詳細に解説して頂くこと  
によって、関連業界の方々の今後の事業に役立てていただくことを目的とします。

日時	2026年3月23日 月曜日 9:55~15:50(予定)
	Webセミナー(Zoomウェビナーによるライブ配信)
聴講料	54,780円(税込)／1名 (テキストを含む)
定員	50名
主催	株式会社 ジャパンマーケティングサーベイ 東京都中央区東日本橋2-24-12 東日本橋榎町ビル Tel: 03-5829-3891 ホームページURL <a href="https://www.jms21.co.jp/">https://www.jms21.co.jp/</a>

## ■講師/タイムテーブル

時間	テーマ	講演企業/講師
9:55~10:00	接続確認・諸連絡	
10:00~12:30	パワーモジュール向け封止材の 設計・開発と技術動向	NBリサーチ 代表 野村 和宏 氏
12:30~13:30	休憩時間	
13:30~15:50	パワーデバイス向け高耐熱接合技術 の最新動向	国立大学法人 大阪大学 接合科学研究所 微細接合学分野 教授 西川 宏 氏

※各講演時間に5分程度の質疑応答を含みます。

## 1. パワーモジュール向け封止材の設計・開発と技術動向 (野村 和宏 氏)

- 1 パワーデバイスの必要性
- 2 パワーデバイスのトレンドと封止材の市場動向
- 3 パワーモジュールの封止法
- 4 パワーモジュール向け封止樹脂の要求特性と設計
- 5 パワーモジュール向け封止材の評価
- 6 パワーデバイス向け封止材の今後

## 2. パワーデバイス向け高耐熱接合技術の最新動向 (西川 宏 氏)

半導体チップ下のダイアタッチ接合部には、依然としてPb含有率85%以上の高鉛含有はんだや、鉛フリーはんだであるSn-Sb系はんだなどが使用されていますが、更なる高耐熱化と高信頼性が望まれています。本講演では、はんだ代替技術として国内外で注目されている金属粒子による焼結型高耐熱接合技術や液相拡散(TLP)接合に注目し、最近の動向について紹介するとともに、これまで研究室でおこなってきたナノ粒子やマイクロサイズ粒子を用いた接合技術、さらには最新の3次元ナノ構造を利用した接合技術などについて、特徴や留意点なども含めて紹介します。

# <申し込み要項>

## ■申し込み方法:

弊社ホームページ及び講演会パンフレットの申込書に所定事項をご記入の上、弊社宛まで送信もしくはFAXお願い致します。

申し込み書受領後に、請求書を発送、またWebセミナーの視聴方法について詳細をご案内いたします。(請求書は開催が決定した場合のみ送付いたします。)

## ■お支払い:

請求書に記載されている弊社指定口座に、請求日より1ヶ月以内にお振込みをお願い申し上げます。

## ■キャンセル:

開催日の10日以内のキャンセルにつきましては、全額申し受けさせていただきます。

## ■特記事項:

- ・講演会は受講者数が規定に達しない場合中止する場合があります。
- ・写真撮影、録音、録画を禁止いたします。

(株)ジャパンマーケティングサーベイ行 FAX: 0120-052-807 or 03-5829-3892

## パワーモジュールのパッケージング技術の動向

(54,780円:税込) 申込書

2026年3月23日(月)開催 <<Webセミナー>>

年 月 日

企業名: \_\_\_\_\_.

申込者名: \_\_\_\_\_.

所属: \_\_\_\_\_ 役職: \_\_\_\_\_.

E-mailアドレス: \_\_\_\_\_.

住所: (〒 \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_.

TEL: \_\_\_\_\_ FAX: \_\_\_\_\_.

連絡事項